

2025학년도

반도체설계 능력평가

반도체설계능력평가란?

반도체융합전공 및 참여 학과 학생을 대상으로 반도체 설계·공정 분야 능력을 필기와 실기로 평가하는 인증 평가입니다.

평가 대상 반도체 설계 능력 인증에 관심있는 반도체융합전공생 및 참여학과 학생

	연번	학과(학부)명
참여 학과 목록	1	전자컴퓨터공학부
	2	신소재공학부
	3	화학공학부
	4	기계공학부
	5	고분자융합소재공학부
	6	화학과
	7	물리학과
	8	지능형모빌리티융합학과(미래모빌리티학과)
	9	석유화학소재공학과
	10	전자통신공학과

평가 방식

①디지털회로설계	필기	디지털 공학 및 하드웨어기술 언어(verilog HDL) 등에 대한 전문지식
	실기	Intel Quartus II EDA 소프트웨어 활용 기술을 바탕으로 디지털 회로 설계 수행
②아날로그회로설계	필기	아날로그 전자회로 및 회로이론 등에 대한 전문지식
	실기	Cadence EDA 소프트웨어 활용 기술을 바탕으로 아날로그 회로 설계 수행
③소자공정설계	필기	반도체 소자 성능 및 제조 공정의 최적화를 위한 기본 개념 및 전문지식
	실기	TCAD EDA 소프트웨어 활용 기술을 바탕으로 반도체 소자 설계 수행

평가 유형

유형	평가시간	평가방법	문항수	합격기준	비고
필기	1시간	객관식 4지 택일형	25문항	50점 이상	필기 합격자에 한해 실기 응시 자격 부여
실기	3시간	과제수행형	1~2문항	-	추후공지

※ 평가방법은 사업단 내부 상황(시설 및 장비 등)에 따라 변형출제 될 수 있습니다.